14 SEP 2002

PCT ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Bureau international

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6 : H01L 21/00 — A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 99/46802

(43) Date de publication internationale: 16 septembre 1999 (16.09.99)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/00520

(22) Date de dépôt international: 9 mars 1999 (09.03.99)

(30) Données relatives à la priorité:
98/02833 9 mars 1998 (09.03.98) FR

(71) Déposant *(pour tous les Etats désignés sauf US)*: S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES [FR/FR]; Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, F-38190 Bernin (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant *(US seulement)*: LAMURE, Jean-Michel [FR/FR]; Hameau de l'Eglise, F-38420 Saint-Jean-le-Vieux (FR).

(74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).

(81) Etats désignés: JP, KR, SG, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée
Avec rapport de recherche internationale.



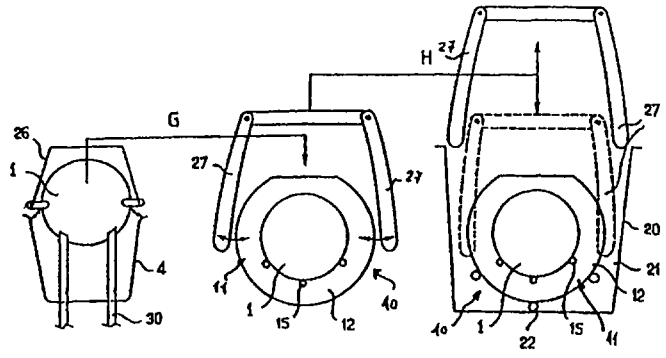
G00002



162162

(54) Title: INSTALLATION AND METHOD FOR CHEMICAL TREATMENT OF MICROELECTRONICS WAFERS

(54) Titre: INSTALLATION ET PROCEDE DE TRAITEMENT CHIMIQUE DE PLAQUETTES POUR LA MICRO-ELECTRONIQUE



(57) Abstract

The invention concerns a installation for treating wafers (1) made of material serving as microelectronics substrates, comprising: a basin (20) for containing a treating bath (21) and provided with means for holding (22) the wafers capable of receiving at least one wafer of a first size; and prehensile means (27) for grasping each wafer of a first size, to place it in the bath and remove it therefrom. The invention is characterised in that it further comprises a support (10) for receiving at least one wafer (1) of a second size smaller than the first size, said support having a shape such that it can be grasped by the prehensile means (27) and be received by the basin (20) wafer-holding means (22).

(57) Abrégé

L'invention concerne une installation de traitement de plaquettes (1) de matériau servant de substrats pour la micro-électronique, comprenant: un bac (20) destiné à contenir un bain (21) de traitement et muni de moyens porte-plaquettes (22) apte à recevoir au moins une plaquette d'une première dimension; et des moyens de préhension (27) aptes à saisir chaque plaquette de la première dimension, pour la mettre dans le bac et la sortir de celui-ci; caractérisé en ce qu'il comporte en outre un support (10) apte à recevoir au moins une plaquette (1) d'une deuxième dimension inférieure à la première dimension, ce support présentant une géométrie telle qu'il peut être saisi par les moyens de préhension (27) et être reçu par les moyens porte-plaquettes (22) du bac (20).